**苏州国芯科技股份有限公司**

**2024年5月7日至5月9日投资者关系活动记录表**

**证券简称：国芯科技 证券代码：688262 编号：2024-009**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | √特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 √业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称** | 南方基金；银华基金；华安基金；平安基金；长安基金；东兴基金；天风证券；中泰证券；国联证券；山西证券；东方证券；青骊投资；华杉投资；上海苓茏投资；丹羿投资；盛宇投资；线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的全体投资者 |
| **时间** | 2024年5月7日9:30；2024年5月7日10:00； 2024年5月7日13:30；2024年5月7日14:30；2024年5月7日15:30；2024年5月9日13:00 |
| **地点** | 上海锦江汤臣酒店会议室；公司会议室及线上交流 |
| **上市公司参加人员姓名** | 董事长：郑茳先生总经理：肖佐楠先生董事会秘书：黄涛先生财务总监：张海滨先生独立董事：张薇女士证券事务代表：龚小刚先生 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录，更多关于公司的情况敬请查阅公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的定期报告和临时报告。投资者本次提问的问题主要如下：**1. 公司汽车芯片不断突破，看过去成果颇多，但量产不足，怎么觉得汽车芯片订单、收入没有多大的增长？如年底汽车芯片订单才4200多万？汽车芯片研发投入很大，没见效益？公司今年目前汽车芯片在手订单如何？今年会大幅度增长吗？汽车芯片成本会降低吗？预计什么时候能赚到钱？公司有这方面规划吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司汽车电子芯片客户经过产品开发、DV/PV测试、量产等一系列高标准要求的流程后，客户对公司的汽车电子产品的高可靠性、技术服务支持的及时性和全面性给予高度认可，2023年有超过100个以上的客户定点项目使用国芯汽车电子芯片。公司以各领域头部企业作为市场推广的重要目标，聚焦大客户，集中优势技术支持来推动大客户、大项目的开发测试及量产。同时以MCU+模式与客户全面合作，即以MCU、混合信号（含驱动类）和通信接口芯片的整体方案来解决客户的“套片”方案式需求，增进与客户合作的广度、深度和粘性，汽车电子优质客户持续增加，基本覆盖各个领域的头部企业。随着公司汽车电子芯片生产销售规模增长，规模化带来成本下降效益会逐步显现，公司与相关供应链企业议价能力增强，预计未来整体成本会有所下降。谢谢！1. 如何展望接下来的毛利率？

答：尊敬的投资者，您好！公司未来将更多侧重于毛利率相对较高的自主芯片和模组业务的发展，如云安全芯片、端安全芯片、汽车电子芯片和Raid芯片等，并进一步加强芯片产品的成本管理和控制。谢谢！**3、您好，问一下3008芯片第三方功能认证D级情况？还有易鼎丰签的50万颗芯片一季度有确认一部分吗？浙江埃创汽车芯片订单一季度有确认一部分吗？**答：尊敬的投资者，您好！ 3008PT芯片功能安全ASIL-D的认证正在正常开展过程中，易鼎丰及浙江埃创项目进展顺利。谢谢！**4、您好，公司研发加三费已经接近50%,毛利率只有20%，这么看公司没法盈利啊，公司已经连续六个季度业绩亏损了,公司有什么扭亏计划吗？24年还有希望盈利吗？**答：尊敬的投资者，您好！公司研发等费用的增长主要是因为研发、市场和技术支持服务人员的增多，这为公司汽车电子芯片和高可靠存储芯片的发展奠定了良好的基础，公司2023年新推出了多款满足市场需求的新产品。公司2024年将全力拓展自主芯片产品的市场应用，公司将继续加强销售团队和技术服务支持团队建设，特别是加强关键市场负责人员和骨干市场成员的能力培养与团队建设，快速聚焦公司资源，快速响应客户需求，切实提升服务客户的质量和效率。2024年，公司会进一步巩固核心市场、核心客户、重点客户，力争进一步扩大批量供货客户的数量和规模，实现市场占用率进一步提升，促进公司业务进一步做大做强，确保公司营收目标达成，以更好的业绩回报广大投资者。谢谢！**5、您好，公司推出全国产raid芯片及板卡也大半年了，一直是小批量销售，进展缓慢，卡在哪里，预计什么时候能大批量销售？**答：尊敬的投资者，您好！目前，公司的Raid控制芯片及板卡已经实现小批量销售。同时，公司的第一代Raid芯片和板卡方案正在10多家国内重点客户进行应用测试，产品正处于多种适配和认证阶段，且进展顺利。这些适配和认证工作涵盖了多个方面，包括与不同操作系统、硬件平台和存储设备的兼容性测试，以及性能和安全性的评估。未来，随着国芯科技在多家国内重点客户测试开发工作的完成，有望迎来更大规模的量产销售。2024年，公司将继续研发第二代Raid芯片，新一代Raid芯片基于高性能RISC-V处理器，采用三模SerDes技术，未来有望实现对目前服务器市场上国外主流RAID芯片的国产化替代。RAID技术主要用于服务器领域，具体应用领域主要面向海量数据存储、AI计算加速、企业关键应用、边缘计算、视频流媒体和网络应用等服务器产品，特别是信创领域相关服务器产品。谢谢！**6、我持有公司股份比较久，希望中失望，市值不断下降，什么时候能让我们分享成果？公司毛利率下降了很多，腰斩，收入规模不够，成本持续上升，研发费用大幅增长，近期有改善吗？公司该如何应对，尽快扭亏，利润走向增长？**答：尊敬的投资者，您好！公司在加大新产品研发的同时，2024年将着重于新产品的市场推广和应用工作，全力将技术创新成果转化为市场收入。同时，公司已经制定并在实施2024年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，争取以更好的业绩回报投资者。谢谢！**7、请问公司二季度及近阶段毛利率会提升吗？单产品成本有下降空间吗**答：尊敬的投资者，您好！公司未来将更多侧重于毛利率相对较高的自主芯片和模组业务的发展，进一步加强产品的成本控制。谢谢！**8、您好，一季度抛去去年未完成定制业务订单一个亿左右，一季度实际营收只有几千万，严重不及预期，公司怎么看？**答：尊敬的投资者，您好！公司一季度完成营收1.79亿元，较上年同期增长9.17%。公司目前在手订单情况较好，公司将全力以赴完成2024年营收目标。2024年一季度以来，汽车电子、信创与信息安全领域的需求在持续回暖，公司一季度的汽车电子芯片的销售数量、收入同比和环比均有一定幅度的增长，公司自主信创和信息安全芯片收入较上年同期增长100%以上。谢谢！**9、您好，一季度有新签定制业务订单吗？**答：尊敬的投资者，您好！公司2024年一季度有新签订定制芯片业务的订单。谢谢！**10、您好，公司23年末合同负债3亿五，24年一季度合同负债2亿6左右，少了一个亿，大幅减少，可是一季度营业收入同比只有不到10个点增长，感觉不能理解，公司23年不断出新品，可是商业化，营收增长缓慢，一季度各板块业务新签订单能说介绍吗？**答：尊敬的投资者，您好！公司目前在手订单情况较好，具体情况请以公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的定期报告和临时报告为准。谢谢！**11、我们在量子领域的相关规划和布局？**答：尊敬的投资者，您好！随着量子信息领域研究的深入和量子计算机研制进度的推进，传统密码学越来越无法满足后量子时代的安全需要，广泛使用的RSA、ECC等公钥密码体制将处于危险状态，因此利用量子安全技术重构现有信息安全的密码体系已成为未来信息安全产品的必然趋势。量子安全技术的实现方式目前主要分为两类：（1）后量子密码（PQC）；（2）量子密码（Quantum Cryptography）。公司已在这两类量子安全技术方面进行研发。在后量子密码（PQC）方向，公司加强PQC方面的密码工程化实现技术研发，包括高性价比的后量子密码算法IP研发、后量子密码抗侧信道攻击和防护技术研究以及相应IP研发。公司预计在2024年内完成支持后量子密码算法的高端SoC芯片设计验证工作。在以量子物理原理为依托的量子密码方向，公司与安徽问天量子科技股份有限公司和合肥硅臻芯片技术有限公司分别组建了量子芯片联合实验室，围绕着量子随机数发生器、量子密钥分发等量子技术和传统芯片、智能终端行业的有机结合，开发适于“量产”的量子安全智能终端可用芯片及设备，主要有量子密码卡、量子安全芯片系列、量子U盘和量子TF卡等。具体包括：（1）2022年，公司首次入股合肥硅臻，同年与合肥硅臻合作成功研发的量子密码卡产品问世。该产品是基于公司CCP903T高性能密码芯片和合肥硅臻QRNG25SPI量子随机数发生器模组设计的一款高速量子密码卡。CCP903T高性能密码芯片是公司自主研发设计并实现全国产化生产的密码安全芯片，内部以C\*CORE C9000 CPU为核心，集成各种高速密码算法引擎、安全防护机制、高速通信接口等，通过国家密码管理局二级密码安全芯片的安全认证。QRNG25SPI量子随机数发生器模组经国家密码管理局商用密码检测中心测试通过，是基于量子集成光芯片研制的量产化量子随机数发生器模组。该量子密码卡遵循国家密码管理局关于PCI密码卡的相关技术规范，具备PCIE、USB OTG和UART等硬件接口。可广泛应用于密码机、签名/验证服务器、安全网关/防火墙等安全设备以及金融、物联网、工业控制、可信计算和国家重大需求等领域，目前已有多个客户在实际使用。（2）2023年，合肥硅臻自主研发的新一代量子随机数发生器芯片“QRNG-10”内部测试成功，该芯片刷新国内量子随机数发生器的尺寸纪录，只有4×4毫米，是国内第一枚突破毫米级尺寸的QRNG芯片，国芯科技配合开展了光后处理电路的研发。该芯片目前已经通过了国家密码管理局商用密码检测中心的密码检测。国芯科技和合肥硅臻于2024年一季度签署了战略合作协议，双方将组建智能终端量子安全芯片联合实验室，基于国芯科技系列化智能终端信息安全芯片和硅臻技术QRNG-10量子随机数发生器芯片联合发展智能终端量子安全芯片技术和产品，共同打造中国智能终端量子安全芯片新技术、新产品及新方案。（3）量子安全TF卡以及量子安全U盘key，用来存储量子会话密钥，量子会话密钥为一次性对称加密密钥，高频次的密钥更新，需要预先在安全TF卡内存储大量的量子会话密钥。量子安全TF卡以及量子安全U盘key可以提供4~32G的存储容量，具有外部认证等鉴权机制保护密钥的安全；可以提供SD通信接口形态以及USB接口形态的产品，易于插拔使用。国芯科技上述多款量子安全产品已经被中电信量子和问天量子等量子领域的头部企业实际采用和实现销售。谢谢！**12、请问下公司一季度在手订单如何？有创历史新高吗？**答：尊敬的投资者，您好！公司目前在手订单情况较好，具体情况请以公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的定期报告和临时报告为准。谢谢！**13、请教郑总，公司汽车电子业务2024年的发展重点是什么？**答：尊敬的投资者，您好！2024年，公司将进一步增强汽车电子芯片产品的丰富度，尤其在域控制器、电机驱动、发动机、新能源电池管理、线控底盘、安全气囊点火控制、DSP主动降噪等应用领域应对客户要求不断优化和细化产品型号，提高产品质量及软件生态丰富度，同时全力推进已量产汽车电子芯片的市场开拓和装车。2024年，公司继续在高端MCU和数模混合信号芯片方面加大研发,并计划于年内推出高集成度的域控制器/ADAS功能安全控制器MCU CCFC3012PT。公司还正在开发CCFC3009PT芯片，这是针对未来汽车电子SoC/MCU芯片算力提升的需要，采用高性能RSIC-V架构CPU，算力可以达到6000DMIPS以上。同时在混合信号执行器应用领域推出集成度更高的线控底盘控制驱动类芯片和门控领域的控制预驱类芯片，进一步研发推出集成MCU和BLCD无刷电机驱动功能的单芯片。公司还会加强在汽车智能传感器方面的研发投入，目前已开发用于安全气囊的加速度传感器芯片，通过了公司内部测试，可与公司已大规模量产装车的安全气囊控制MCU以及开始装车的安全气囊点火驱动专用芯片CCL1600B，组成方案套片，为客户提供更高BOM性价比的安全气囊电子系统解决方案。2024年，针对汽车电子芯片，公司将持续完善质量管理制度和内控流程，对涵盖汽车电子芯片产品的设计开发、生产、测试、检验、包装、储存、运输、变更控制等过程的质量管理进行不断优化，将进一步加强产品质量建设，做一个让客户信赖的企业。2024年，公司将继续加强销售团队和技术服务支持团队建设，特别是加强关键市场负责人员和骨干市场成员的能力培养与团队建设，快速聚焦公司资源，快速响应客户需求，切实提升服务客户的质量和效率。2024年，公司会进一步巩固核心市场、核心客户、重点客户，确保公司营收目标达成。在服务好原有客户的基础上，采取多元化的销售策略，加强重点领域头部客户的拓展工作，力争进一步扩大批量供货客户的数量和规模，实现汽车电子市场占用率进一步提升，促进公司业务进一步发展。围绕前述12条产品线，公司将继续坚持“顶天立地”和“铺天盖地”的发展战略，抓住我国汽车电子芯片国产化替代的历史机遇，推进资源优化和聚焦，注重产品技术平台化和系列化，为汽车行业提供更先进、安全可靠的解决方案，为汽车电子芯片国产化做出更大贡献。谢谢！ |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2024年5月 |